

证券代码：688173

证券简称：希荻微

公告编号：2026-014

希荻微电子集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：**安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、大额存单、协定存款、组合存款等）
- 投资金额：**不超过人民币 40,000 万元
- 已履行的审议程序**

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示

尽管本次现金管理是投资安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

（三）资金来源

发行名称	2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022 年 1 月 17 日		
募集资金总额	134,313.57 万元		
募集资金净额	122,140.85 万元		
超募资金总额	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用， 63,971.84 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目	100.00	已于 2025 年 9 月 25 日结项
	新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目	85.52	2026 年 4 月
	总部基地及前沿技术研发项目	50.13	2026 年 6 月
	补充流动资金	100.00	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：上表的累计投入进度为截至 2025 年 11 月 30 日的募集资金累计投入进度；公司拟将总部基地及前沿技术研发项目达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 12 月，具体详见公司同日披露的《关于部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》。

（四）投资方式

1. 投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）投资安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、大额存单、协定存款、组合存款等），投

资产产品的期限最长不超过 12 个月。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2. 实施方式

公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述额度及使用期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的金融机构、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3. 现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后本金及其收益将归还至募集资金专项账户。

4. 信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管规则》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2025年1月24日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币45,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，同意公司将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放，存款期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司以及中

国国际金融股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-005）。截至2026年1月16日，公司最近12个月未使用募集资金购买结构性存款、通知存款大额存单等低风险保本型投资产品进行现金管理；公司尚未使用的募集资金余额37,092.49万元，其中专户活期存款余额3,115.22万元，协定存款余额33,977.27万元。

二、审议程序

公司于2026年1月23日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币40,000万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管本次现金管理是投资安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照《募集资金监管规则》《科创板股票上市规则》《规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2. 公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
3. 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进

展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4. 董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募投项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金（含超募资金）适度、适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项具有合理性和必要性。

公司将严格按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理理财产品进行相应会计核算。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司和中国国际金融股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项符合《募集资金监管规则》《科创板股票上市规则》《规范运作》等法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行；在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。

六、上网公告附件

(一) 《国联民生证券承销保荐有限公司关于希荻微电子集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

(二) 《中国国际金融股份有限公司关于希荻微电子集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026年1月24日